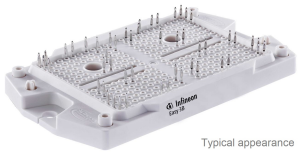
Final datasheet
EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und PressFIT / NTC

Eigenschaften


Typical appearance

- Elektrische Eigenschaften
  - V_{CES} = 1200 V
  - $I_{C\,nom}$ = 200 A / I_{CRM} = 400 A
  - Erhöhte Zwischenkreisspannung
  - Hohe Stromdichte
  - Niedrige Schaltverluste
  - Geeignete Infineon Gate-Treiber finden Sie unter https://www.infineon.com/gdfinder
- Mechanische Eigenschaften
  - Hochstrom-Pin
  - Integrierter NTC Temperatur Sensor
  - PressFIT Verbindungstechnik
  - Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern

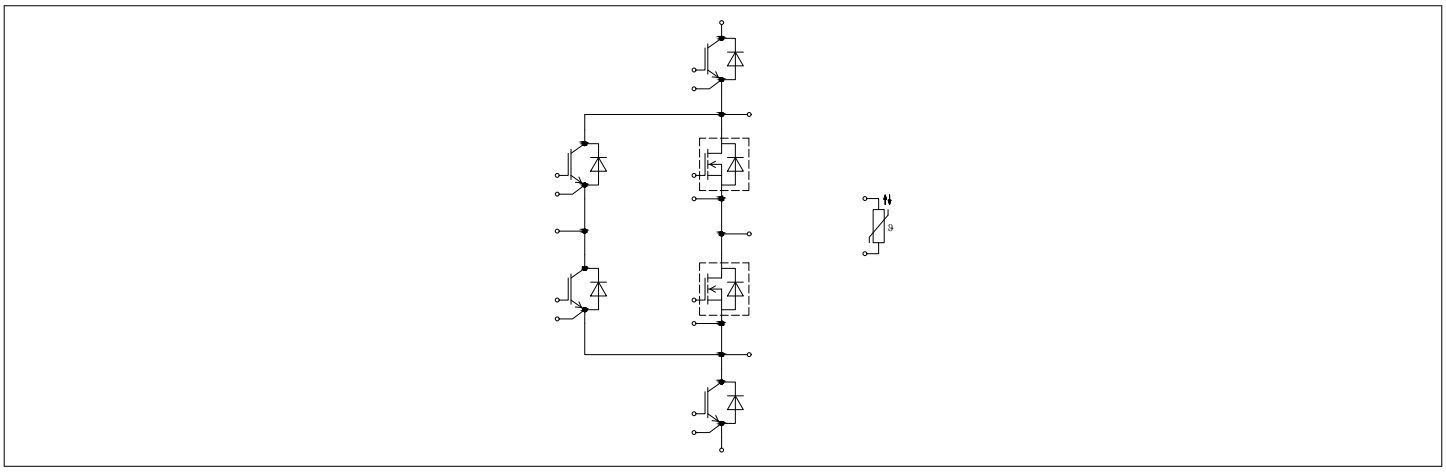
Potenzielle Anwendungen

- 3-Level-Applikationen
- Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen
- Solar Anwendungen

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	**Gehäuse**	3
2	**IGBT, T1 / T4**	3
3	**MOSFET, T2 / T3**	5
4	**Body diode (MOSFET, T2 / T3)**	7
5	**IGBT, T5 / T6**	7
6	**Diode, D1 / D4**	9
7	**Diode, D5 / D6**	10
8	**NTC-Widerstand**	11
9	**Kennlinien**	12
10	**Schaltplan**	27
11	**Gehäuseabmessungen**	28
12	**Modul-Label-Code**	29
	Änderungshistorie	30
	Disclaimer	31

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.2	kV
Isolationsprüfspannung NTC	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.2	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 400	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	*RTI*	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}				39		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, pro Schalter			2.4		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	1.3		1.5	Nm
Gewicht	*G*				78		g

***Anmerkung**:The current under continuous operation is limited to 50A rms per connector pin.*

2 IGBT, T1 / T4

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	950	V
Implementierter Kollektor-Strom	I_{CN}			200	A
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 65 °C	180	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		400	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 200 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.30	1.40	V
			T_{vj} = 125 °C		1.35		
			T_{vj} = 150 °C		1.35		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 3.25 mA, V_{CE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C		4.15	4.9	5.65	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V, T_{vj} = 25 °C			2.05		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			1.5		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			24.6		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.114		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 950 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			37	µA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 18 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.298		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.268		
			T_{vj} = 150 °C		0.254		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 18 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.045		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.056		
			T_{vj} = 150 °C		0.059		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω	T_{vj} = 25 °C		3.390		µs
			T_{vj} = 125 °C		3.580		
			T_{vj} = 150 °C		3.590		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.212		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.372		
			T_{vj} = 150 °C		0.443		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 7 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 18 Ω, di/dt = 2800 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		21.9		mJ
			T_{vj} = 125 °C		27		
			T_{vj} = 150 °C		28.5		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 7 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω, dv/dt = 1600 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		32		mJ
			T_{vj} = 125 °C		40.3		
			T_{vj} = 150 °C		42.8		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.439		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

3 MOSFET, T2 / T3

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Drain-Source-Spannung	V_{DSS}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Implementierter Drain-Strom	I_{DN}			240	A
Drain-Dauergleichstrom	I_{DDC}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = 18 V	T_H = 65 °C	215	A
Periodischer Drain-Spitzenstrom	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		530	A
Gate-source Spannung, max. transiente Spannung	V_{GS}	D < 0.01		-10/23	V
Gate-source Spannung, max. statische Spannung	V_{GS}			-7/20	V

Tabelle 6 Empfohlene Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Ein-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Aus-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	I_D = 240 A	V_{GS}=18 V, T_{vj} = 25 °C		2.91	3.82	mΩ
			V_{GS}=18 V, T_{vj} = 125 °C		4.7		
			V_{GS}=18 V, T_{vj} = 175 °C		6.24		
			V_{GS}=15 V, T_{vj} = 25 °C		3.4		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	I_D = 112 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25 °C, (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V)		3.45	4.3	5.15	V
Gateladung	Q_G	V_{DD}=800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			0.8		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj}=25 °C			1.9		Ω
Eingangskapazität	C_{ISS}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		24.2		nF
Ausgangskapazität	C_{OSS}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		1.2		nF

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 7 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Rückwirkungskapazität	C_{rss}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		0.079		nF
C_{OSS} Speicherenergie	E_{OSS}	V_{DS}=800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			473		µJ
Drain-Source-Reststrom	I_{DSS}	V_{DS} = 1200 V, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		0.16	378	µA
Gate-Source-Reststrom	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, T_{vj} = 25 °C	V_{GS}=20 V			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\,on}$	I_D = 240 A, R_{Gon} = 4.7 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 V_{GS} to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		78		ns
			T_{vj} = 125 °C		78		
			T_{vj} = 175 °C		78		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_D = 240 A, R_{Gon} = 4.7 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 I_D to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		122		ns
			T_{vj} = 125 °C		115		
			T_{vj} = 175 °C		114		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\,off}$	I_D = 240 A, R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 V_{GS} to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		100		ns
			T_{vj} = 125 °C		111		
			T_{vj} = 175 °C		117		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_D = 240 A, R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 I_D to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		25		ns
			T_{vj} = 125 °C		26		
			T_{vj} = 175 °C		27		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_D = 240 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 7 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Gon} = 4.7 Ω, di/dt = 5.7 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		7.08		mJ
			T_{vj} = 125 °C		7.15		
			T_{vj} = 175 °C		7.16		
Einschaltverlustenergie pro Puls, optimiert	$E_{on,o}$	I_D = 240 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 7 nH, V_{GS} = -3/18 V, $R_{Gon,o}$ = 3 Ω, di/dt = 7.1 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		4.51		mJ
			T_{vj} = 125 °C		4.54		
			T_{vj} = 175 °C		4.55		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_D = 240 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 7 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Goff} = 1 Ω, dv/dt = 17.5 kV/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		3.02		mJ
			T_{vj} = 125 °C		3.51		
			T_{vj} = 175 °C		3.68		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro MOSFET, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.283		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

***Anmerkung**:The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Note AN 2018-09 and AN 2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.*

Tvj,op > 150°C is allowed for operation at overload conditions for MOSFET and body diode. For detailed specifications, please refer to AN 2021-13

4 Body diode (MOSFET, T2 / T3)

Tabelle 8 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Body Diode-Gleichstrom	I_{SD}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3 V	T_H = 65 °C	95	A

Tabelle 9 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_{SD}	I_{SD} = 240 A, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		4.11	5.35	V
			T_{vj} = 125 °C		3.85		
			T_{vj} = 175 °C		3.75		
Rückstromspitze	I_{rrm}	I_{SD} = 240 A, di_s/dt = 5.5 kA/µs, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		74		A
			T_{vj} = 125 °C		109		
			T_{vj} = 175 °C		134		
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	I_{SD} = 240 A, di_s/dt = 5.5 kA/µs, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		1.3		µC
			T_{vj} = 125 °C		2.7		
			T_{vj} = 175 °C		3.9		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	I_{SD} = 240 A, di_s/dt = 5.5 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		0.38		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.89		
			T_{vj} = 175 °C		1.16		
Abschaltenergie pro Puls, optimiert	$E_{rec,o}$	I_{SD} = 240 A, di_s/dt = 6.9 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		0.46		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.64		
			T_{vj} = 175 °C		0.91		

5 IGBT, T5 / T6

Tabelle 10 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	950	V
Implementierter Kollektor-Strom	I_{CN}			200	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 10 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 65 °C	160	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		400	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 11 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 200 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.30	1.40	V
			T_{vj} = 125 °C		1.35		
			T_{vj} = 150 °C		1.35		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 3.25 mA, V_{CE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C		4.15	4.9	5.65	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V, T_{vj} = 25 °C			2.05		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			1.5		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			24.6		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.114		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 950 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			32	µA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 18 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.269		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.255		
			T_{vj} = 150 °C		0.235		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 18 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.052		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.065		
			T_{vj} = 150 °C		0.066		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω	T_{vj} = 25 °C		3.420		µs
			T_{vj} = 125 °C		3.580		
			T_{vj} = 150 °C		3.590		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.174		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.332		
			T_{vj} = 150 °C		0.363		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 11 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 7 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 18 Ω, di/dt = 2500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		25.6		mJ
			T_{vj} = 125 °C		31.5		
			T_{vj} = 150 °C		34.2		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 7 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω, dv/dt = 1600 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		29.9		mJ
			T_{vj} = 125 °C		37.7		
			T_{vj} = 150 °C		40.1		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.517		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

6 Diode, D1 / D4

Tabelle 12 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Dauergleichstrom	I_F			300	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		600	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	7380	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	6320	

Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 160 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.41	1.64	V
			T_{vj} = 125 °C		1.28		
			T_{vj} = 150 °C		1.25		
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 600 V, I_F = 160 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		99		A
			T_{vj} = 125 °C		143		
			T_{vj} = 150 °C		155		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 600 V, I_F = 160 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		15		µC
			T_{vj} = 125 °C		30		
			T_{vj} = 150 °C		35		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 13 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 600 V, I_F = 160 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		4.47		mJ
			T_{vj} = 125 °C		9.81		
			T_{vj} = 150 °C		11.8		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.402		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

7 Diode, D5 / D6

Tabelle 14 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Dauergleichstrom	I_F			200	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		400	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	5060	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	4920	

Tabelle 15 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 200 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.72	2.10	V
			T_{vj} = 125 °C		1.59		
			T_{vj} = 150 °C		1.56		
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 600 V, I_F = 200 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2800 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		101		A
			T_{vj} = 125 °C		126		
			T_{vj} = 150 °C		134		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 600 V, I_F = 200 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2800 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		12		µC
			T_{vj} = 125 °C		25		
			T_{vj} = 150 °C		30		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 600 V, I_F = 200 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2800 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		3.57		mJ
			T_{vj} = 125 °C		8.51		
			T_{vj} = 150 °C		10.3		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 15 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)		0.447		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$		-40		150	°C

8 NTC-Widerstand

Tabelle 16 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

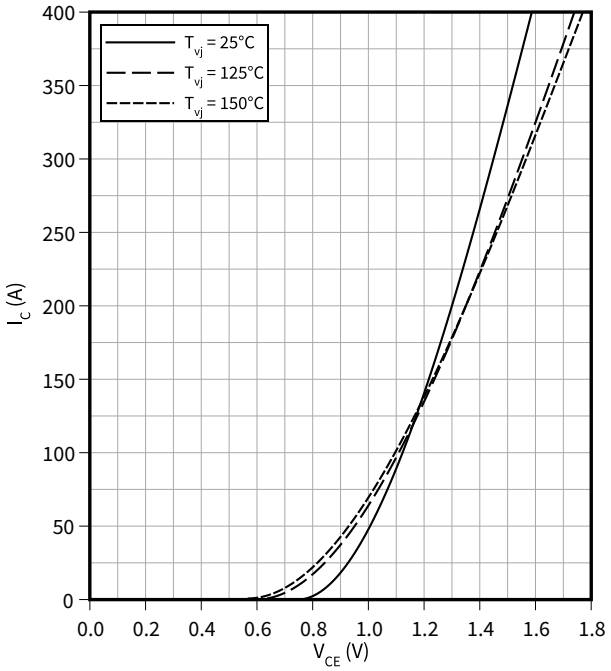
***Anmerkung**:Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4.*

9 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, T1 / T4

$I_C = f(V_{CE})$

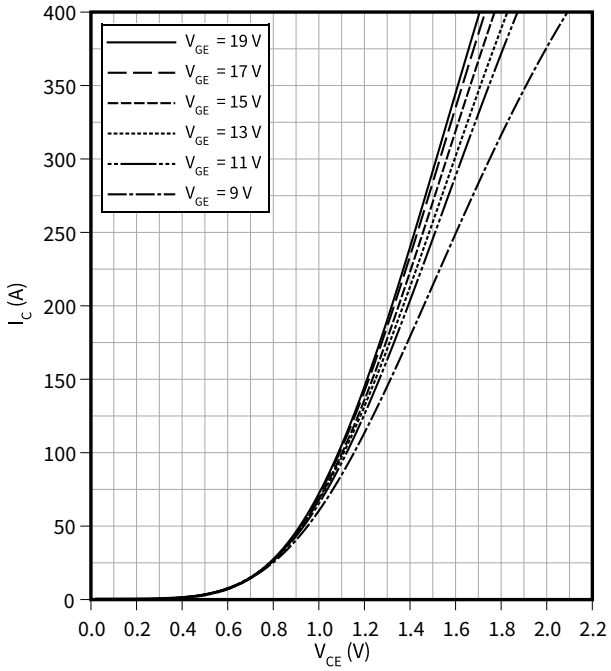
V_{GE} = 15 V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, T1 / T4

$I_C = f(V_{CE})$

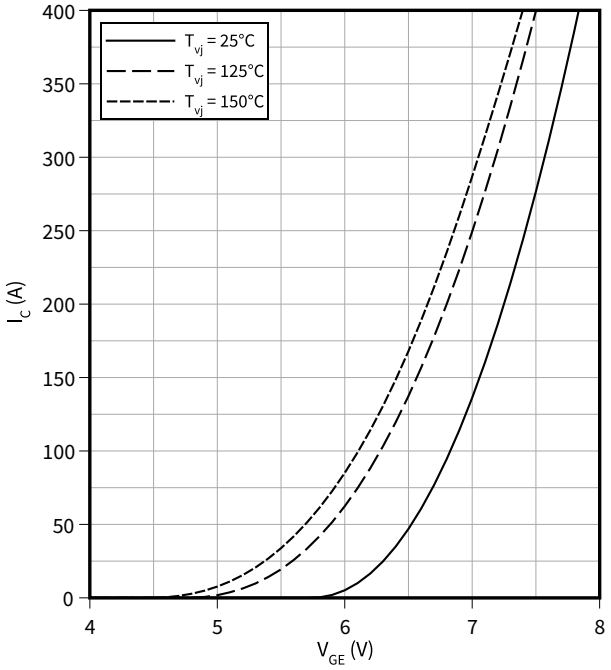
T_{vj} = 150 °C



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, T1 / T4

$I_C = f(V_{GE})$

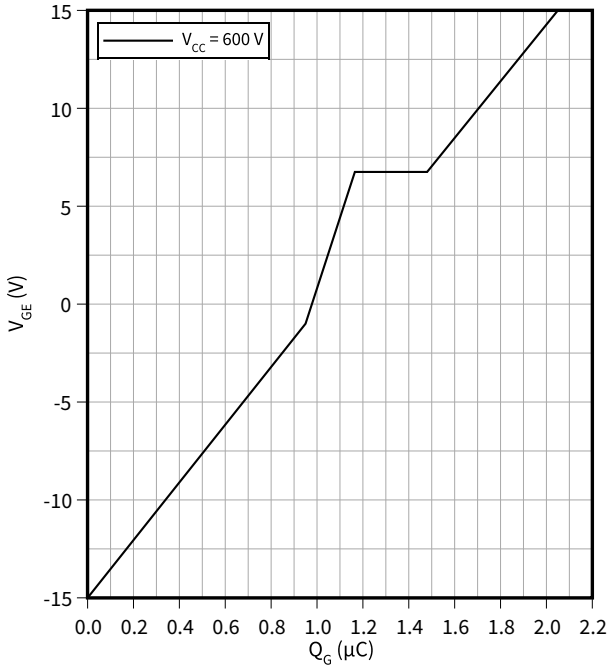
V_{CE} = 20 V



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, T1 / T4

$V_{GE} = f(Q_G)$

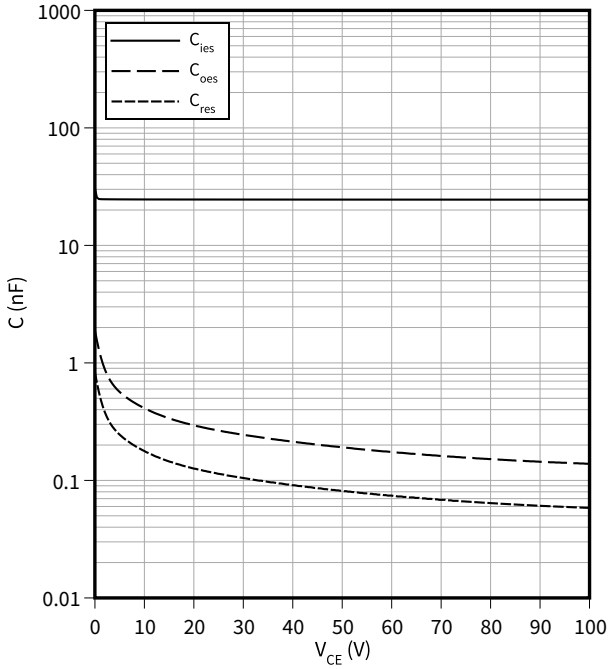
I_C = 200 A, T_{vj} = 25 °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, T1 / T4

$C = f(V_{CE})$

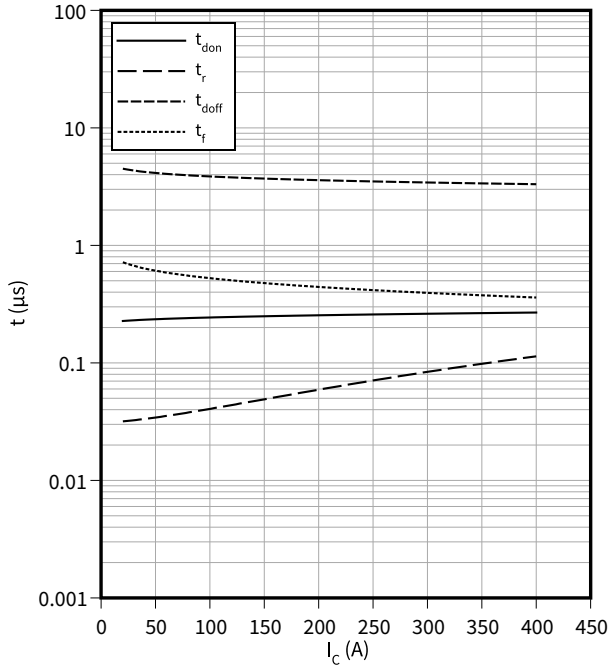
$f = 100\ kHz$, $V_{GE} = 0\ V$, $T_{vj} = 25\ °C$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, T1 / T4

$t = f(I_C)$

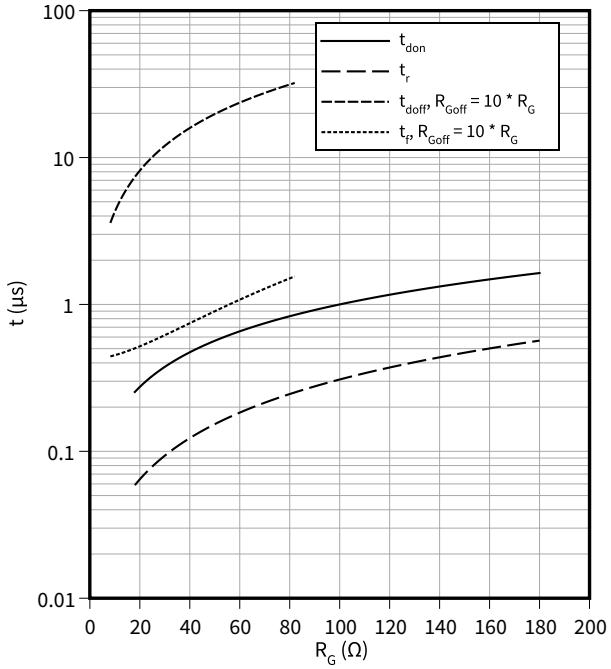
$V_{CC} = 600\ V$, $T_{vj} = 150\ °C$, $R_{Goff} = 82\ Ω$, $R_{Gon} = 18\ Ω$, $V_{GE} = ±15\ V$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, T1 / T4

$t = f(R_G)$

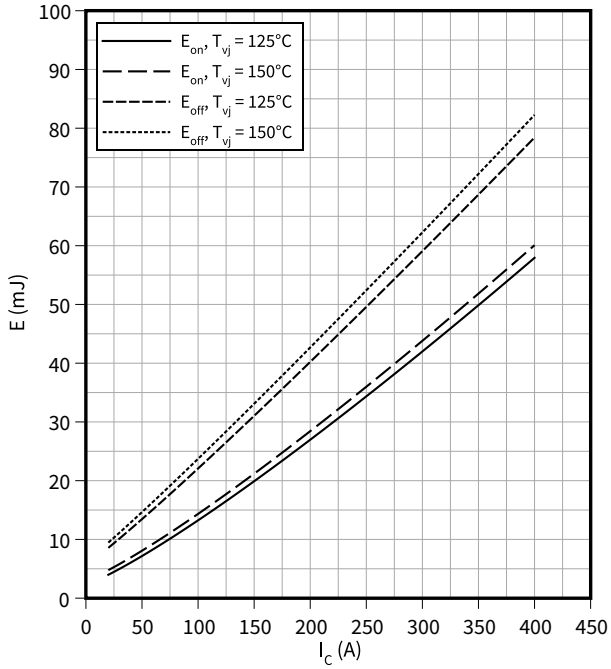
$V_{GE} = ±15\ V$, $I_C = 200\ A$, $V_{CC} = 600\ V$, $T_{vj} = 150\ °C$



Schaltverluste (typisch), IGBT, T1 / T4

$E = f(I_C)$

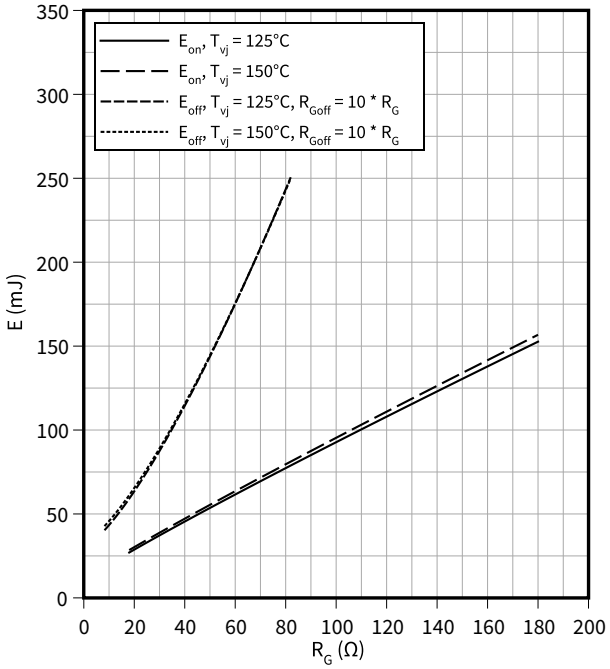
$R_{Goff} = 82\ Ω$, $R_{Gon} = 18\ Ω$, $V_{GE} = ±15\ V$, $V_{CC} = 600\ V$



Schaltverluste (typisch), IGBT, T1 / T4

$E = f(R_G)$

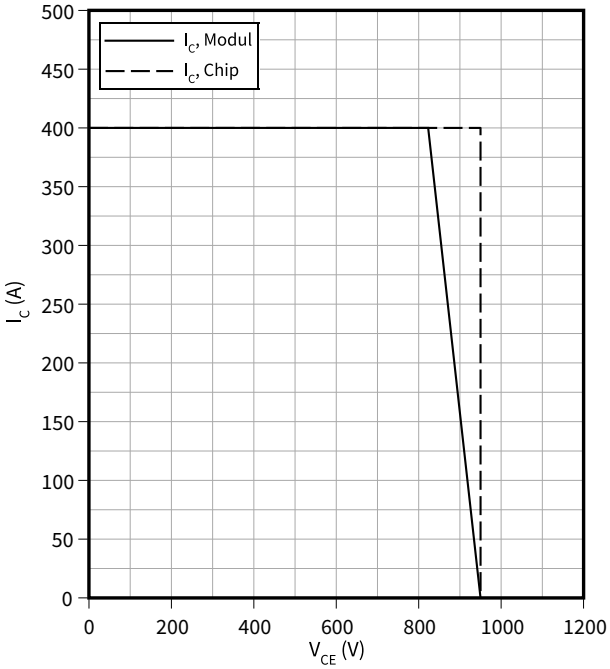
$V_{GE} = \pm 15$ V, $I_C = 200$ A, $V_{CC} = 600$ V



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, T1 / T4

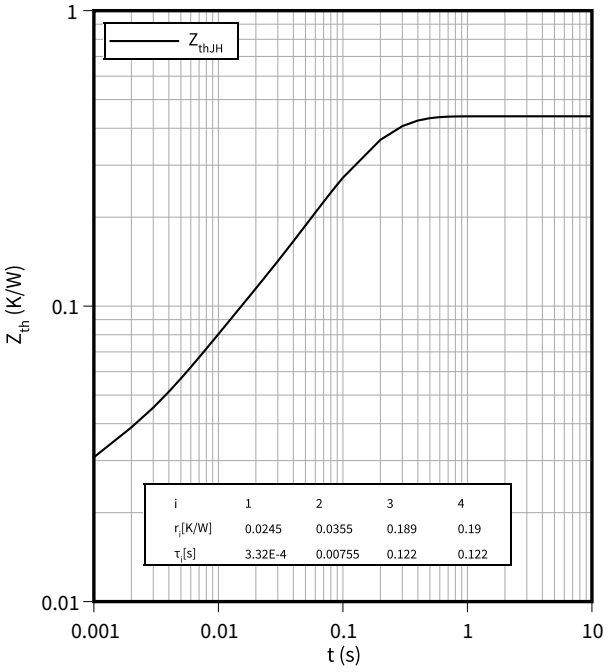
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 82\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V, $T_{vj} = 150$ °C



Transienter Wärmewiderstand, IGBT, T1 / T4

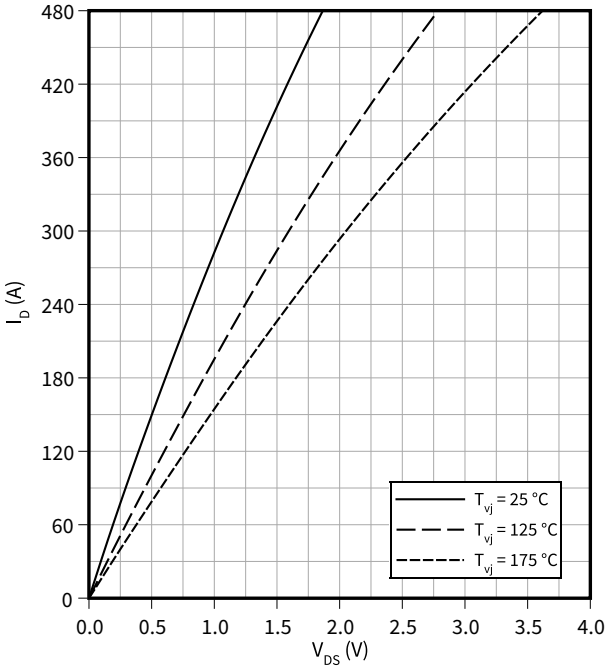
$Z_{th} = f(t)$



Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET, T2 / T3

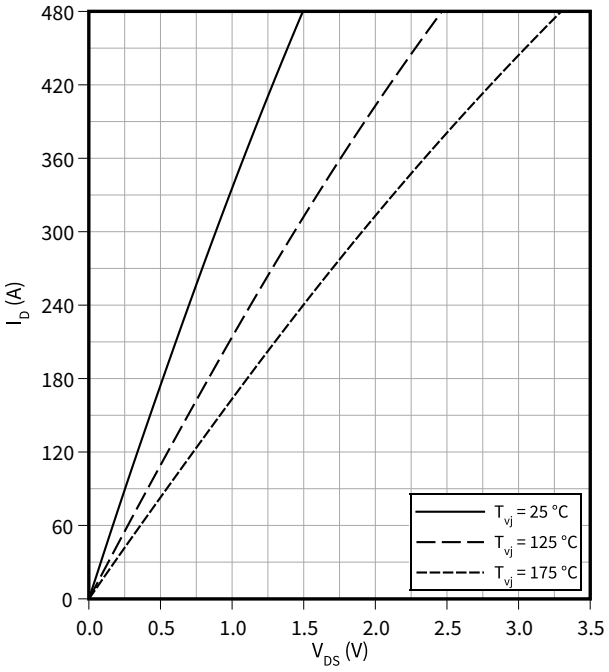
$I_D = f(V_{DS})$

$V_{GS} = 15$ V



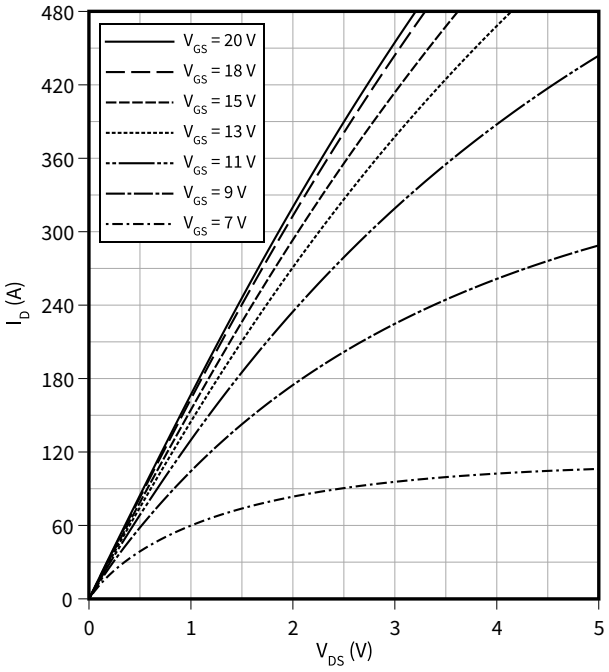
Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET, T2 / T3

$I_D = f(V_{DS})$
$V_{GS} = 18\ V$



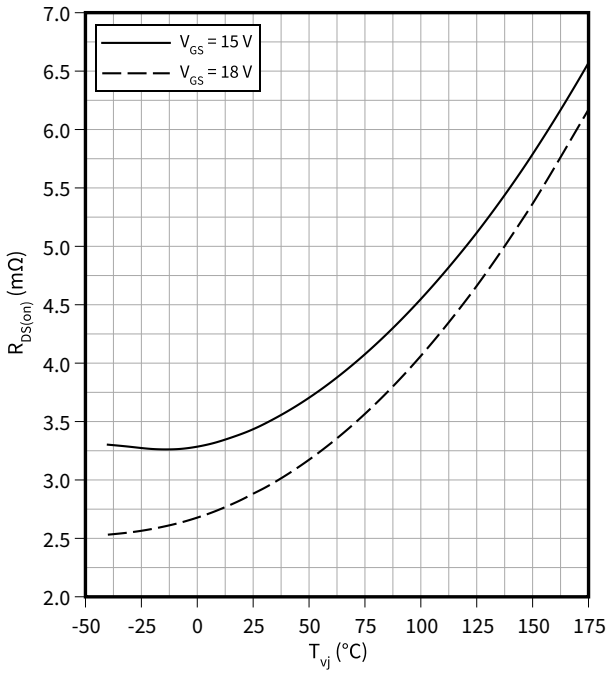
Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET, T2 / T3

$I_D = f(V_{DS})$
$T_{vj} = 175\ °C$



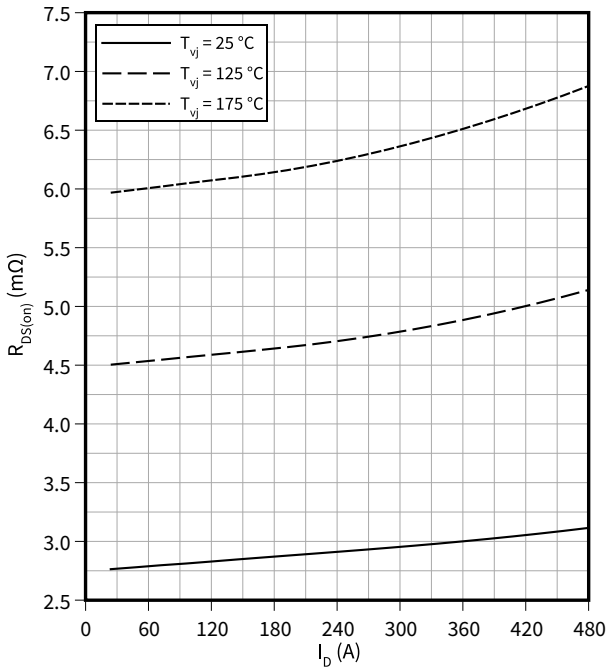
Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET, T2 / T3

$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$
$I_D = 240\ A$



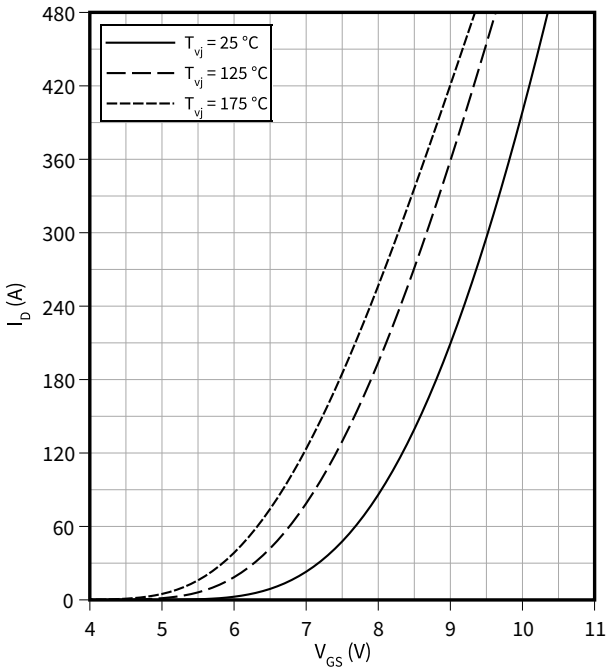
Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET, T2 / T3

$R_{DS(on)} = f(I_D)$
$V_{GS} = 18\ V$



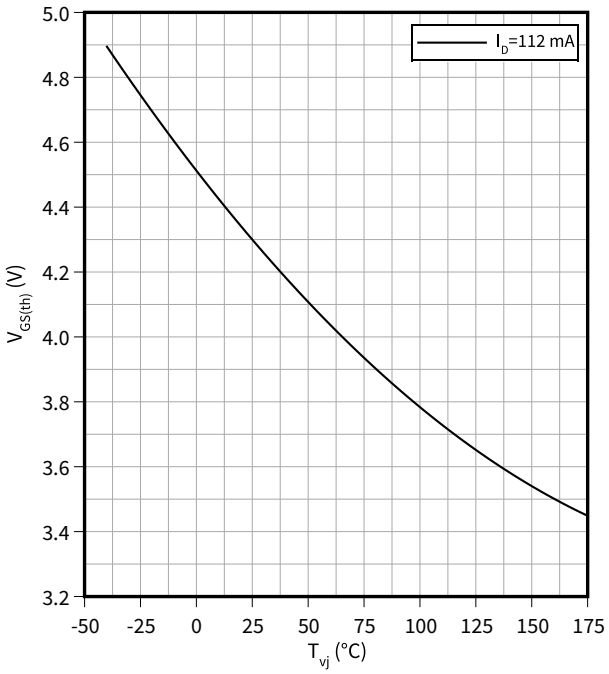
Übertragungscharakteristik (typisch), MOSFET, T2 / T3

$I_D = f(V_{GS})$
$V_{DS} = 20$ V



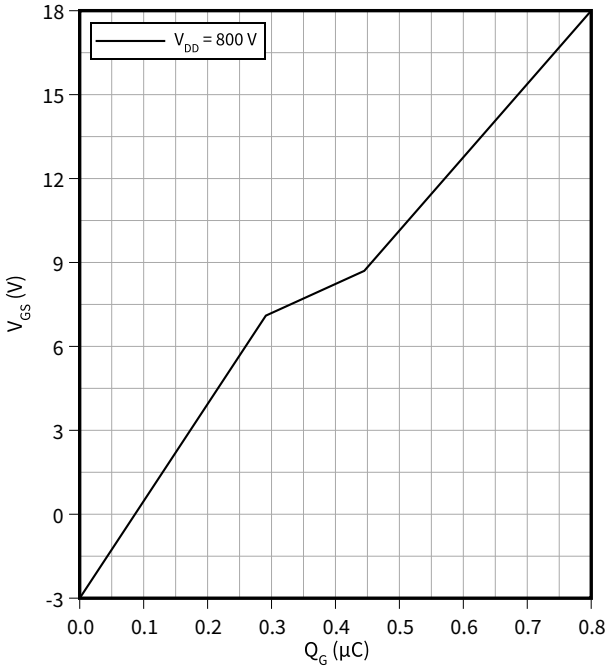
Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET, T2 / T3

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
$V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 112$ mA



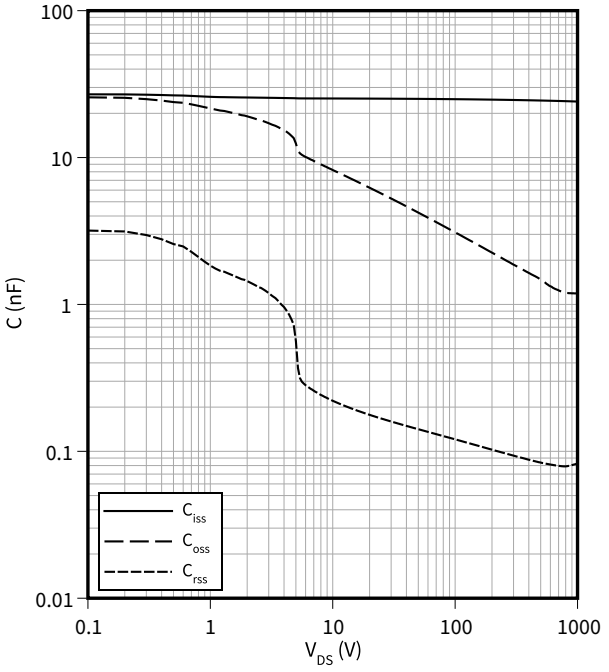
Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET, T2 / T3

$V_{GS} = f(Q_G)$
$I_D = 240$ A, $T_{vj} = 25$ °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), MOSFET, T2 / T3

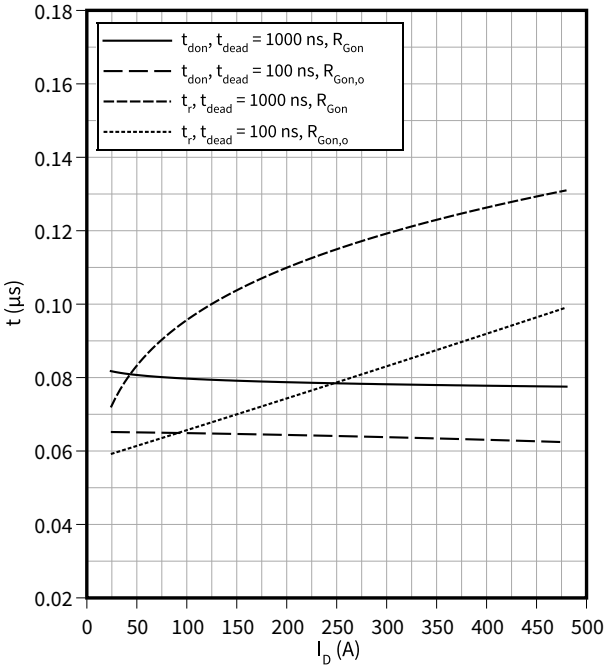
$C = f(V_{DS})$
$f = 100$ kHz, $T_{vj} = 25$ °C, $V_{GS} = 0$ V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T2 / T3

t = f(I_D)

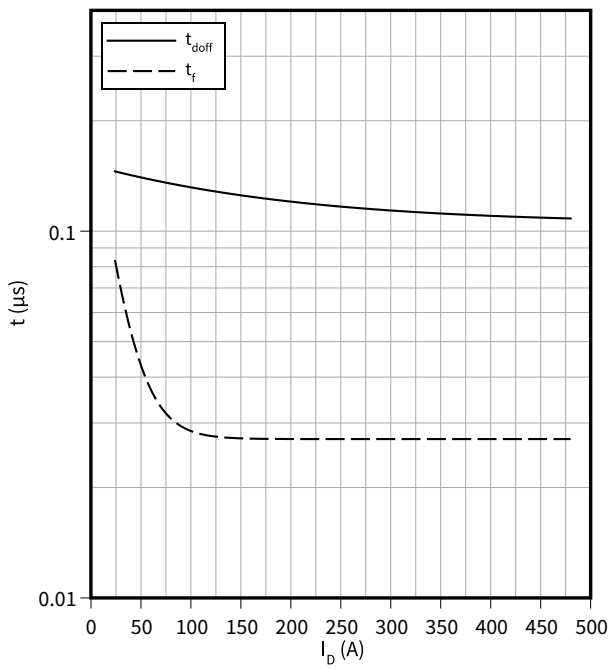
V_{DD} = 600 V, R_{Gon} = 4.7 Ω, $R_{Gon,o}$ = 3 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T2 / T3

t = f(I_D)

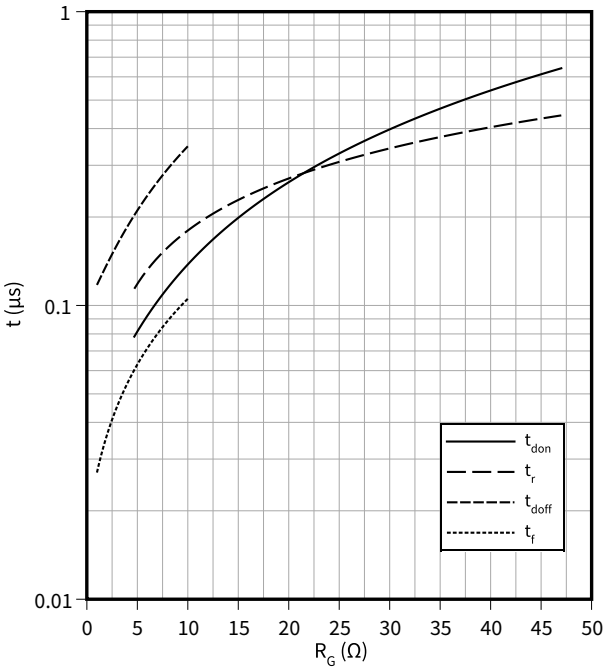
R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 600 V, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T2 / T3

t = f(R_G)

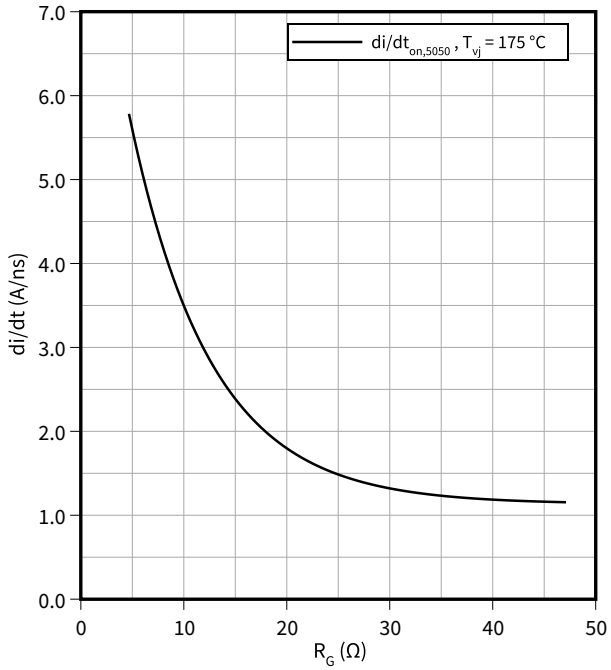
V_{DD} = 600 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 240 A, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Stromsteilheit (typisch), MOSFET, T2 / T3

di/dt = f(R_G)

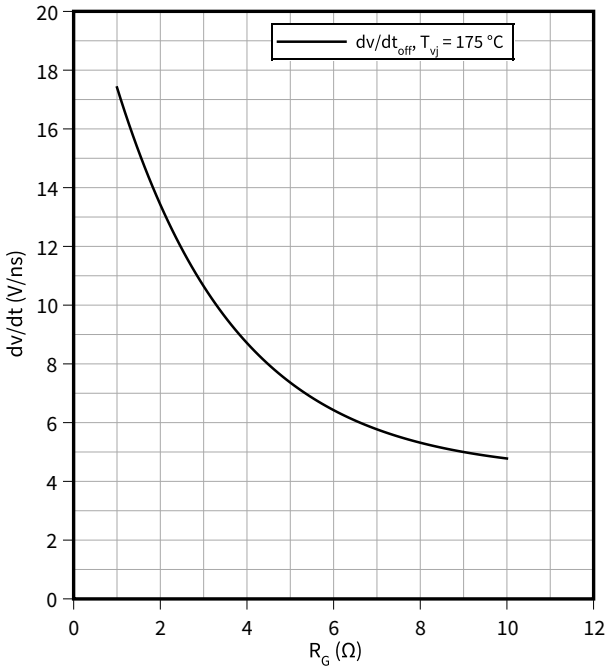
V_{DD} = 600 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 240 A, V_{GS} = -3/18 V



Spannungssteilheit (typisch), MOSFET, T2 / T3

$dv/dt = f(R_G)$

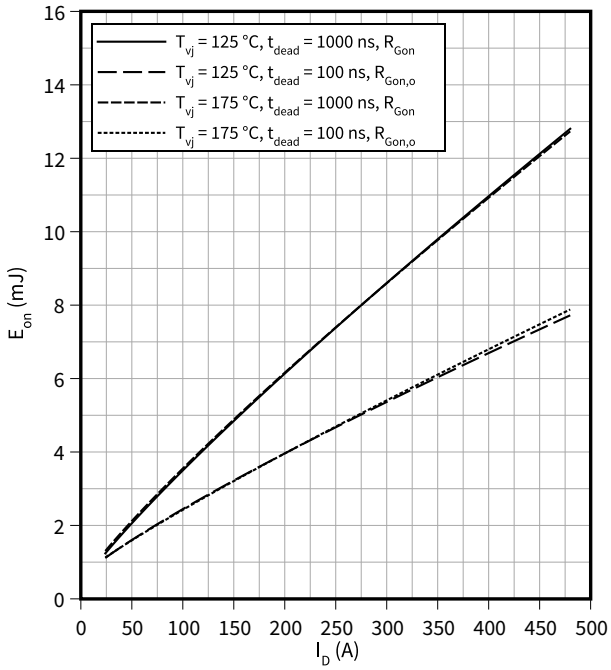
V_{DD} = 600 V, I_D = 240 A, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T2 / T3

$E_{on} = f(I_D)$

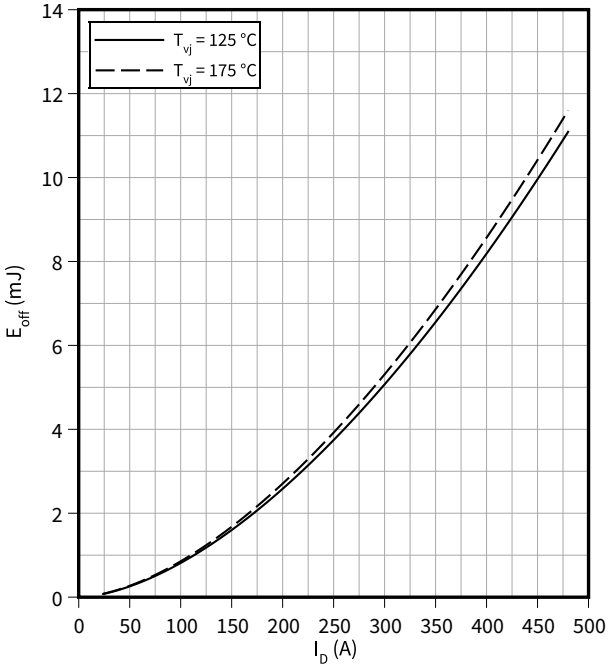
R_{Gon} = 4.7 Ω, V_{DD} = 600 V, $R_{Gon,o}$ = 3 Ω, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T2 / T3

$E_{off} = f(I_D)$

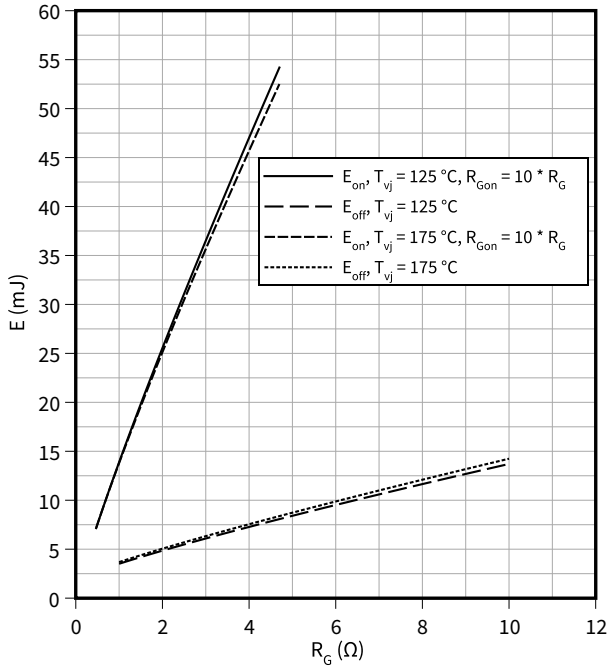
R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T2 / T3

$E = f(R_G)$

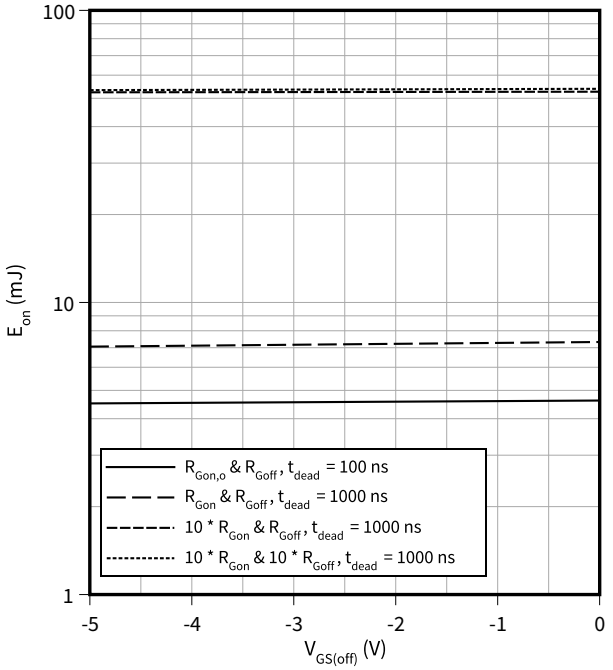
V_{DD} = 600 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 240 A, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T2 / T3

$E_{on} = f(V_{GS(off)})$

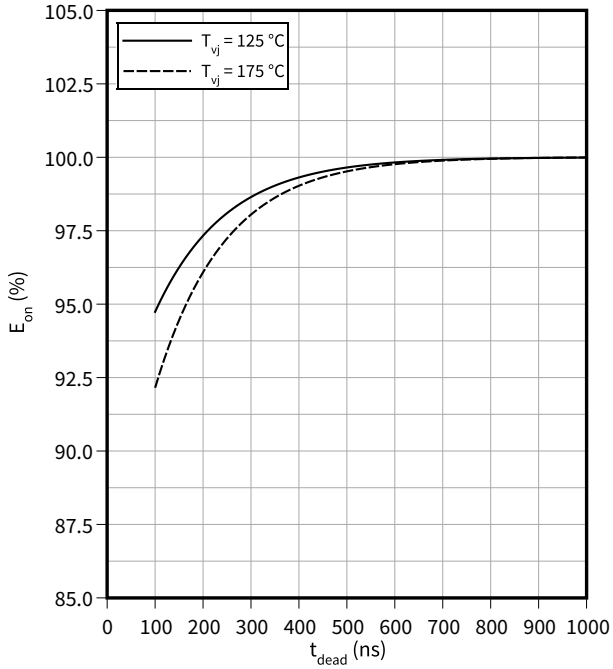
R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 600 V, R_{Gon} = 4.7 Ω, $V_{GS(on)}$ = 18 V, I_D = 240 A, $R_{Gon,o}$ = 3 Ω, T_{vj} = 175 °C



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T2 / T3

$E_{on} = f(t_{dead})$

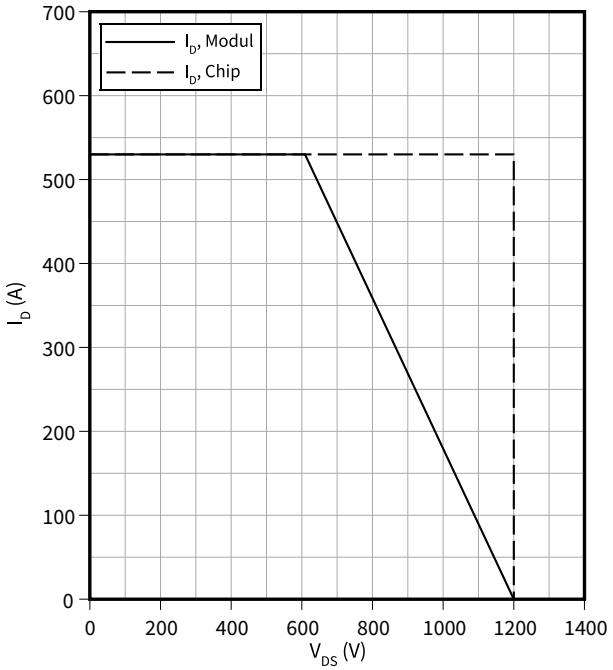
R_{Gon} = 4.7 Ω, I_D = 240 A, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET, T2 / T3

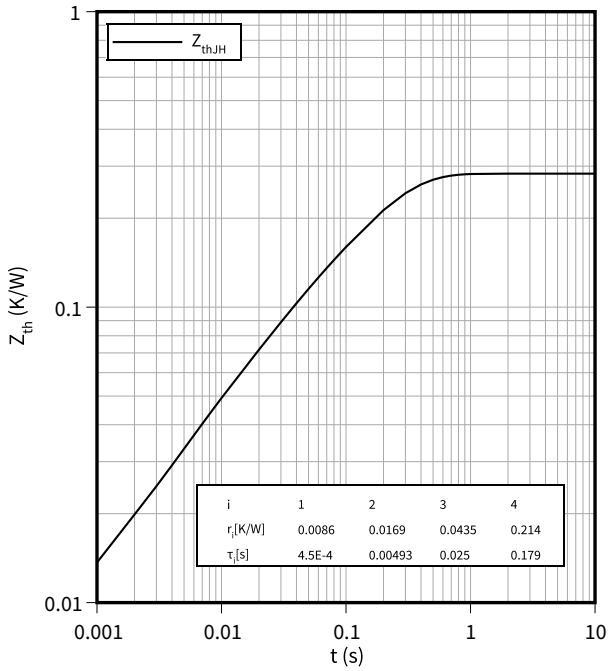
$I_D = f(V_{DS})$

R_{Goff} = 1 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



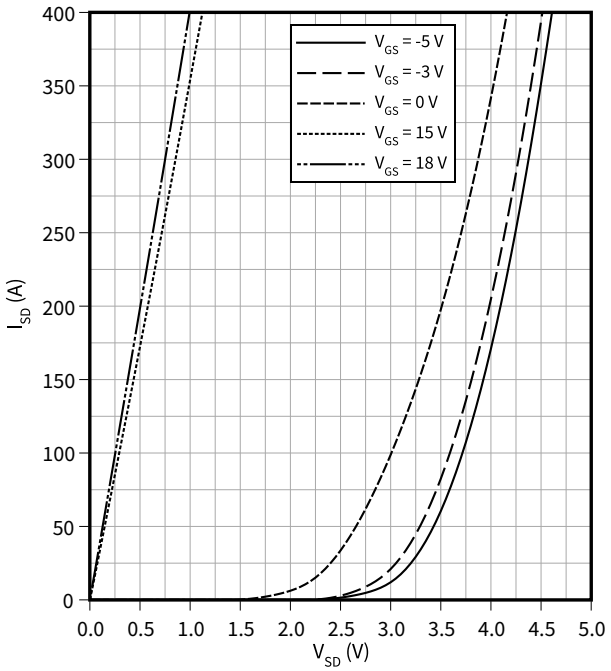
Transienter Wärmewiderstand, MOSFET, T2 / T3

$Z_{th} = f(t)$



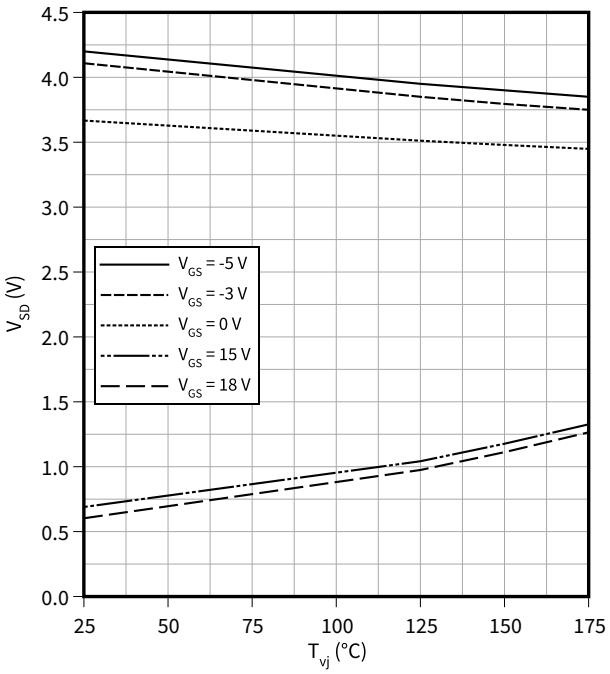
Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET, T2 / T3

$I_{SD} = f(V_{SD})$
$T_{vj} = 25\ °C$



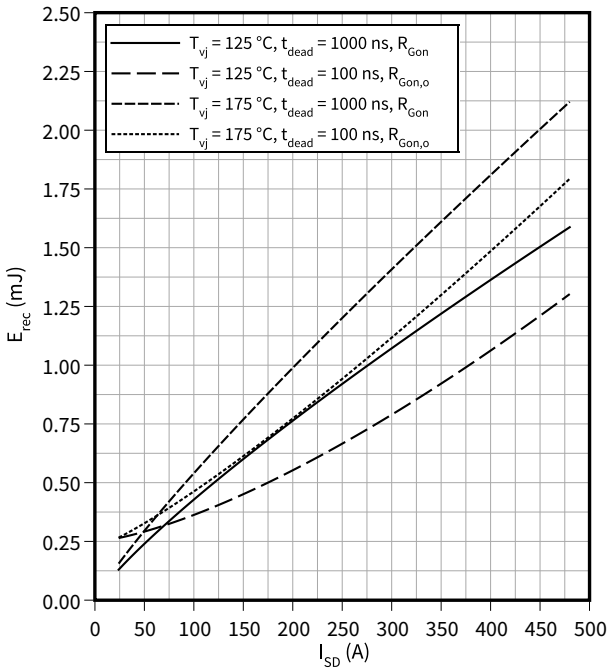
Durchlassspannung der Body-Diode (typisch), MOSFET, T2 / T3

$V_{SD} = f(T_{vj})$
$I_{SD} = 240\ A$



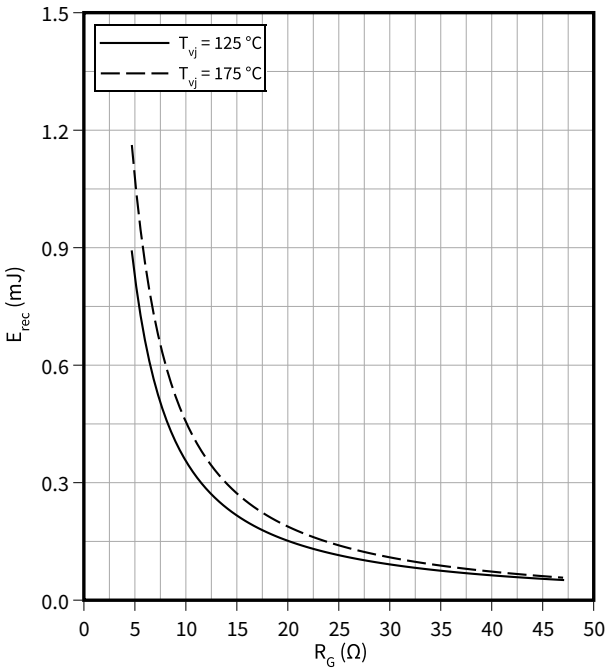
Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T2 / T3

$E_{rec} = f(I_{SD})$
$R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $R_{Gon,o} = 3\ \Omega$, $V_{DD} = 600\ V$



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T2 / T3

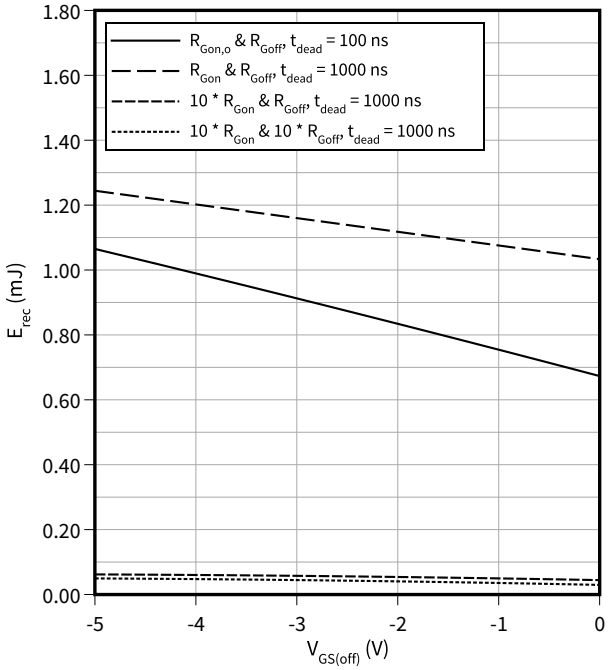
$E_{rec} = f(R_G)$
$t_{dead} = 1000\ ns$, $I_{SD} = 240\ A$, $V_{DD} = 600\ V$



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T2 / T3

$E_{rec} = f(V_{GS(off)})$

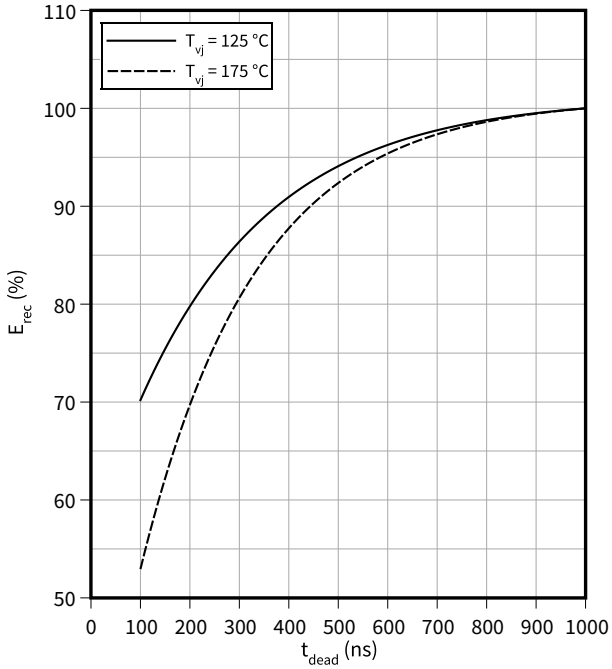
$R_{Goff} = 1\ \Omega$, $R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $V_{GS(on)} = 18$ V, $I_{SD} = 240$ A, $R_{Gon,o} = 3\ \Omega$, $V_{DD} = 600$ V, $T_{vj} = 175$ °C



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T2 / T3

$E_{rec} = f(t_{dead})$

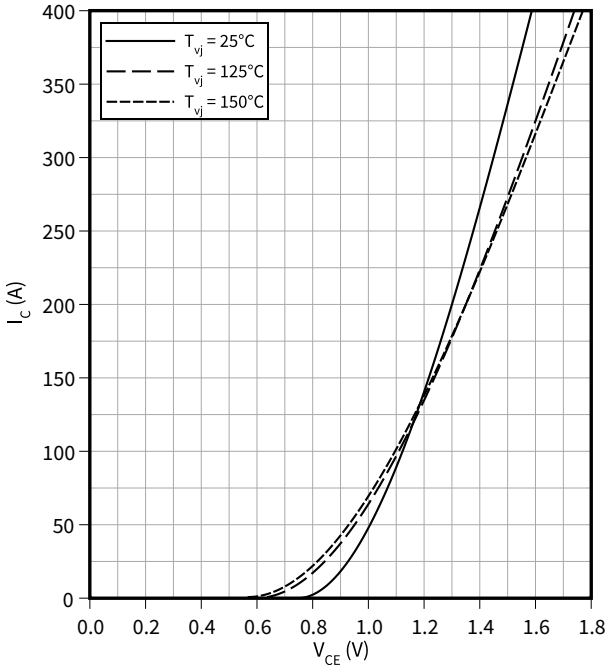
$R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $I_D = 240$ A, $V_{DD} = 600$ V, $V_{GS} = -3/18$ V



Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, T5 / T6

$I_C = f(V_{CE})$

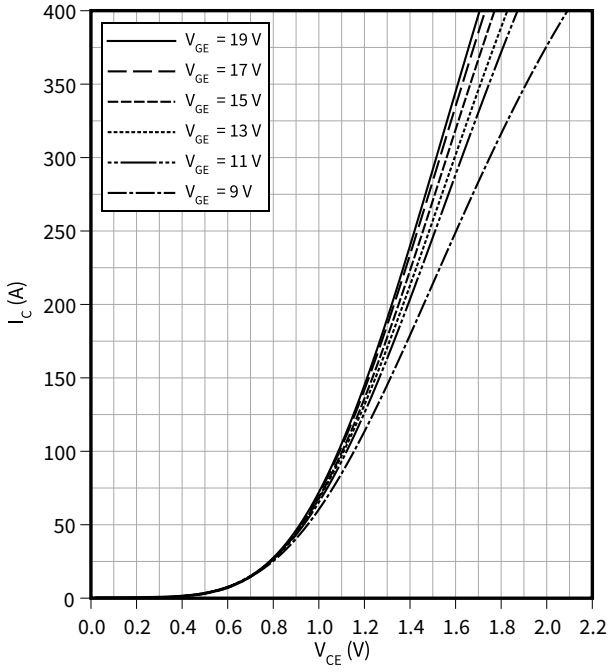
$V_{GE} = 15$ V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, T5 / T6

$I_C = f(V_{CE})$

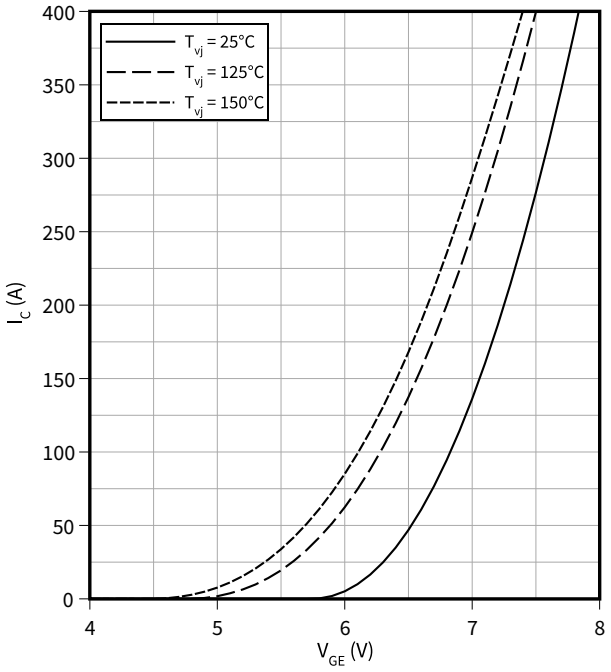
$T_{vj} = 150$ °C



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, T5 / T6

$I_C = f(V_{GE})$

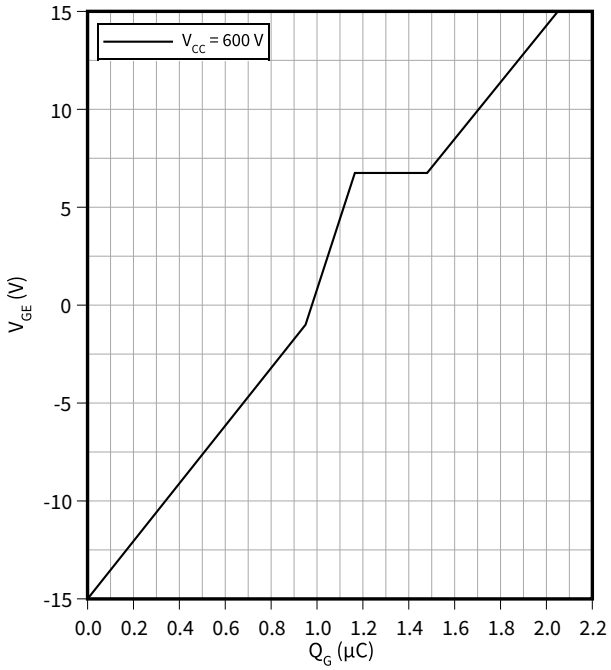
$V_{CE} = 20$ V



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, T5 / T6

$V_{GE} = f(Q_G)$

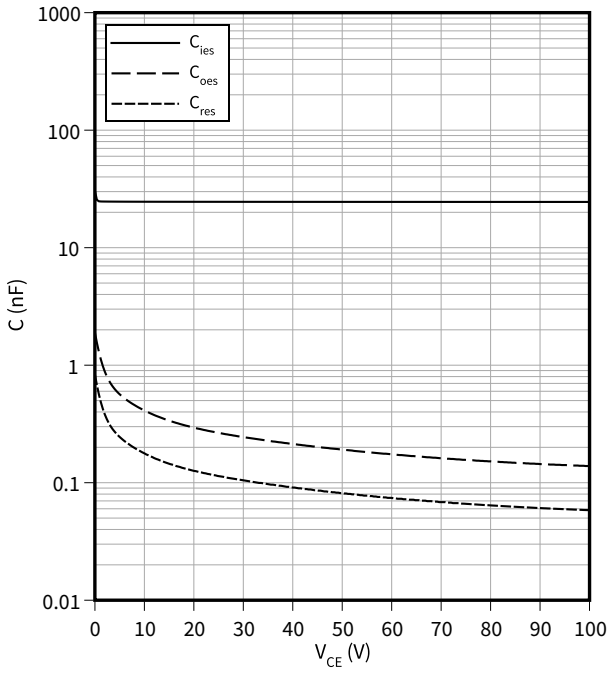
$I_C = 200$ A, $T_{vj} = 25$ °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, T5 / T6

$C = f(V_{CE})$

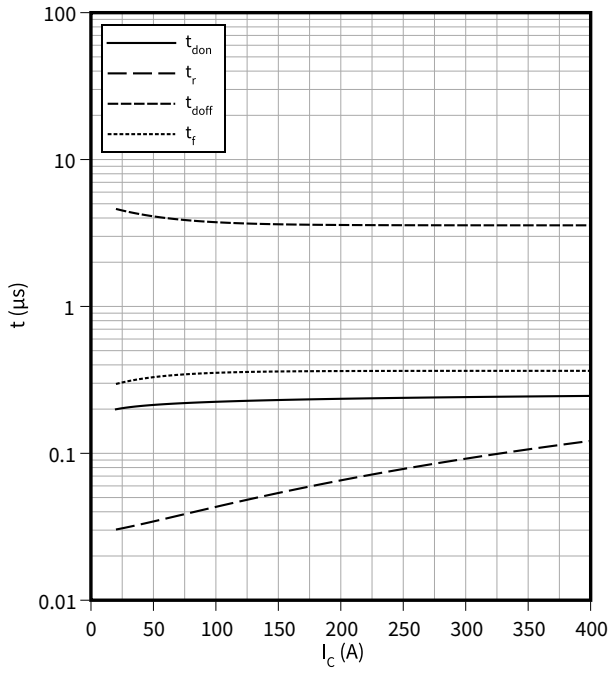
$f = 100$ kHz, $V_{GE} = 0$ V, $T_{vj} = 25$ °C



Schaltzeiten (typisch), IGBT, T5 / T6

$t = f(I_C)$

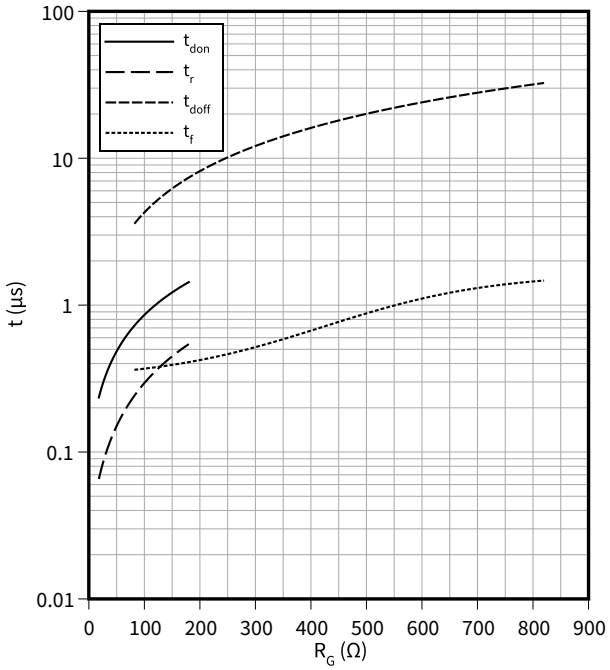
$R_{Goff} = 82\ \Omega$, $R_{Gon} = 18\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V, $V_{CC} = 600$ V, $T_{vj} = 150$ °C



Schaltzeiten (typisch), IGBT, T5 / T6

$t = f(R_G)$

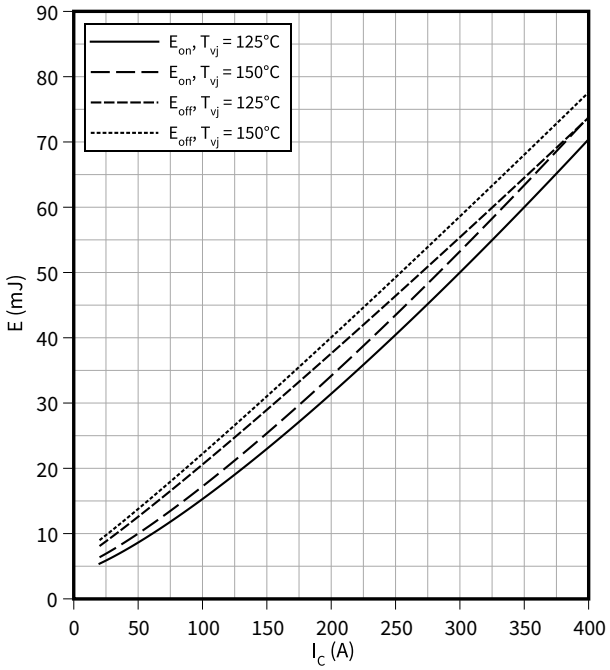
V_{GE} = ±15 V, I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V, T_{vj} = 150 °C



Schaltverluste (typisch), IGBT, T5 / T6

$E = f(I_C)$

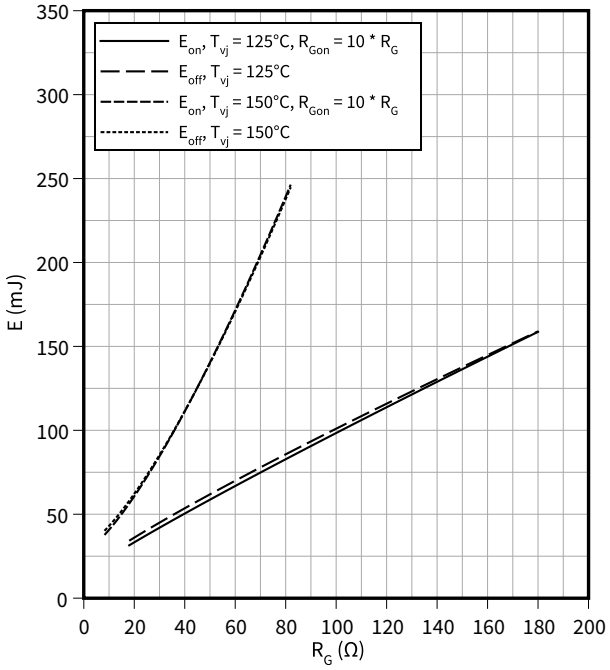
R_{Goff} = 82 Ω, R_{Gon} = 18 Ω, V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V



Schaltverluste (typisch), IGBT, T5 / T6

$E = f(R_G)$

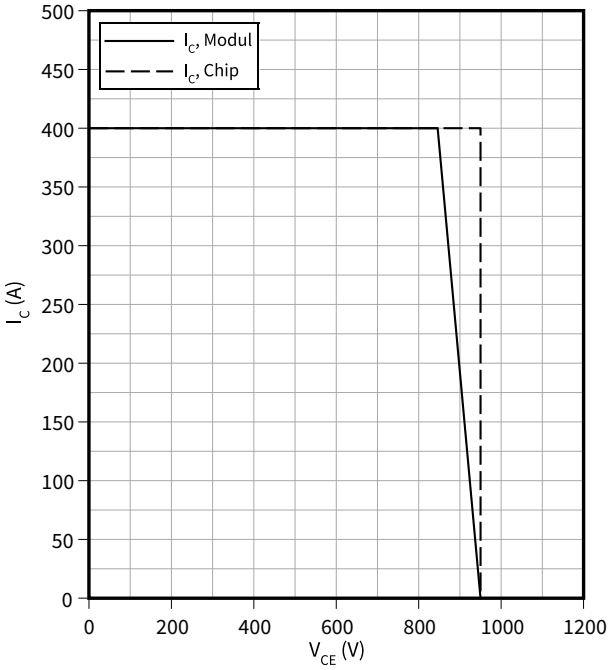
V_{GE} = ±15 V, I_C = 200 A, V_{CC} = 600 V



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, T5 / T6

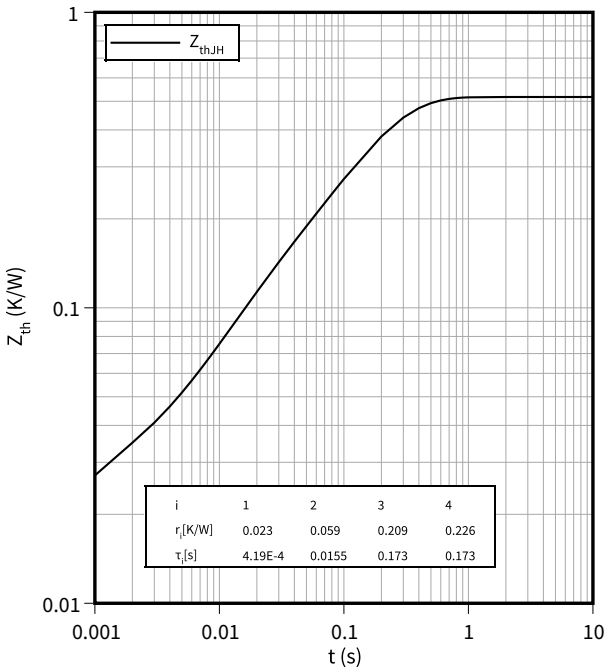
$I_C = f(V_{CE})$

R_{Goff} = 82 Ω, V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 150 °C



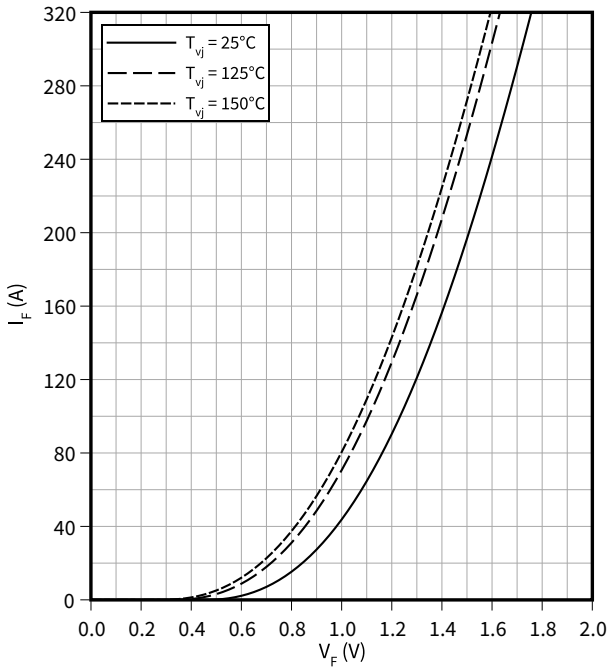
Transienter Wärmewiderstand, IGBT, T5 / T6

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, D1 / D4

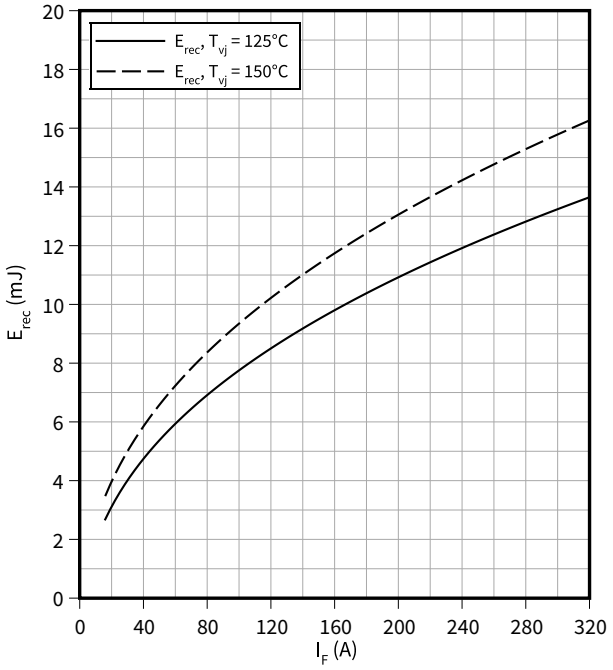
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, D1 / D4

$E_{rec} = f(I_F)$

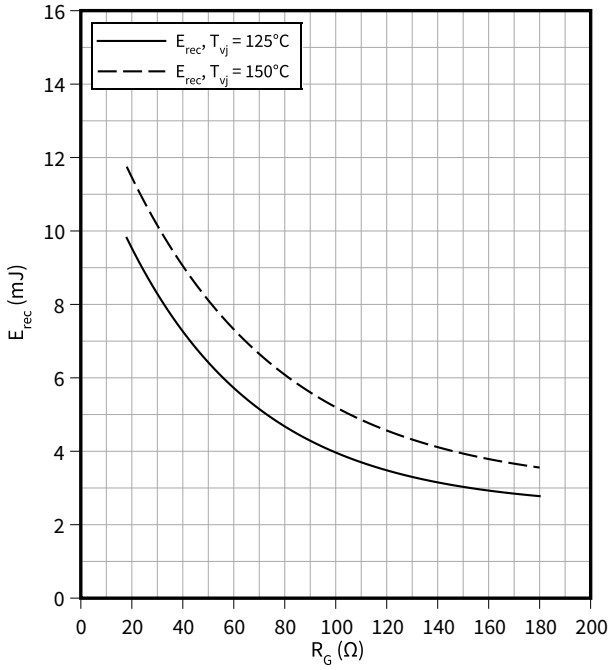
$R_G = 18\ \Omega$, $V_{CC} = 600\ V$



Schaltverluste (typisch), Diode, D1 / D4

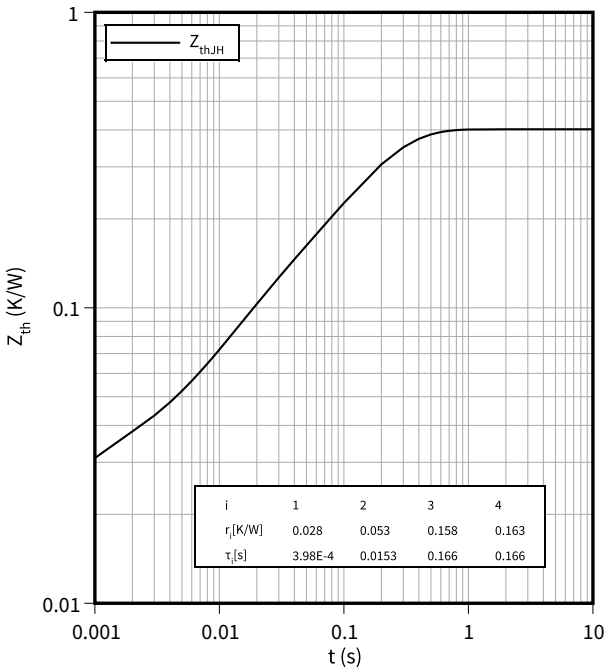
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 160\ A$, $V_{CC} = 600\ V$



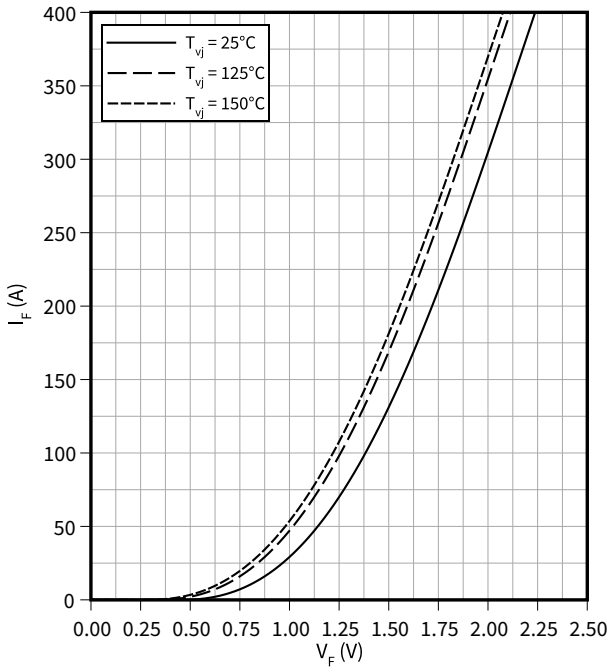
Transienter Wärmewiderstand, Diode, D1 / D4

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, D5 / D6

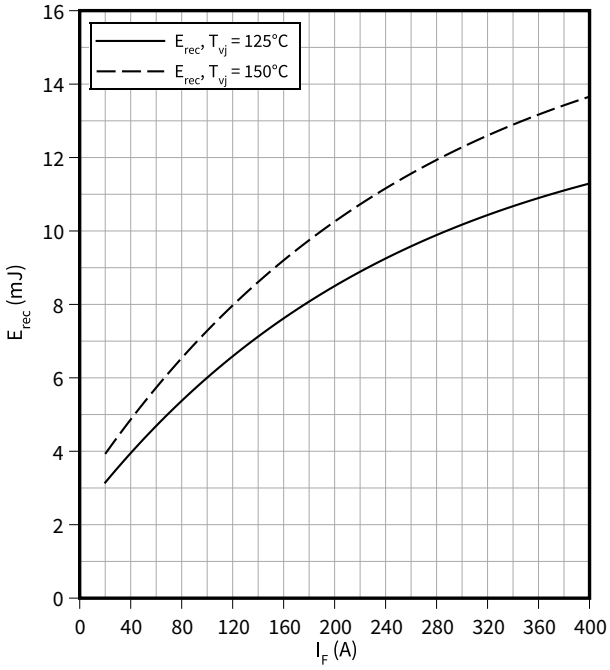
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, D5 / D6

$E_{rec} = f(I_F)$

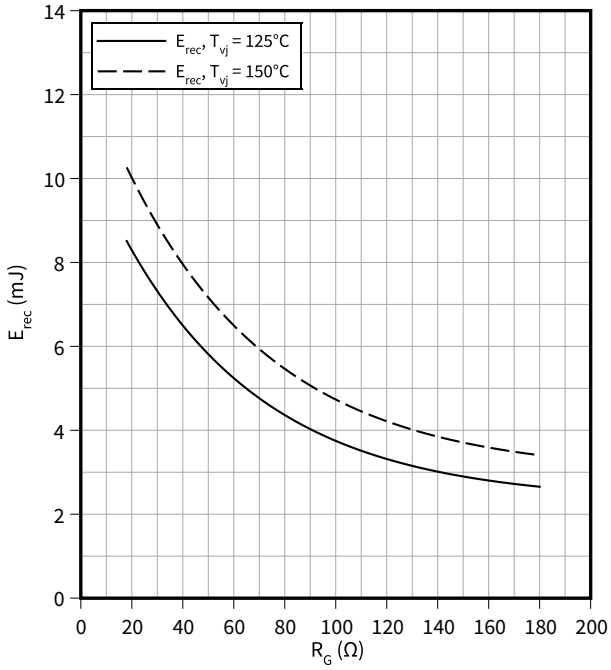
$R_{Gon} = 18\ \Omega$, $V_{CC} = 600$ V



Schaltverluste (typisch), Diode, D5 / D6

$E_{rec} = f(R_G)$

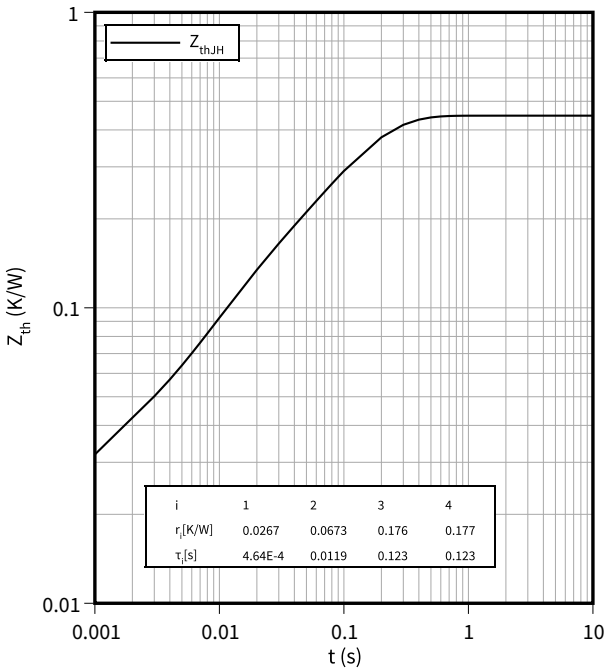
$I_F = 200$ A, $V_{CC} = 600$ V



9 Kennlinien

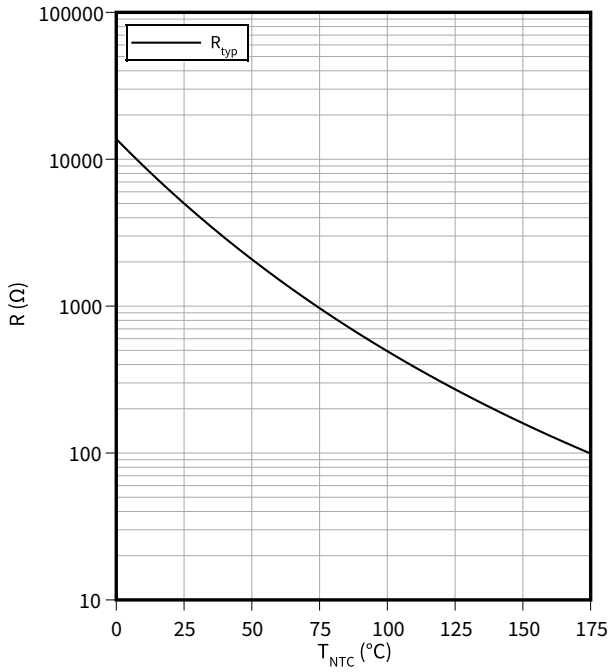
Transienter Wärmewiderstand, Diode, D5 / D6

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



10 Schaltplan

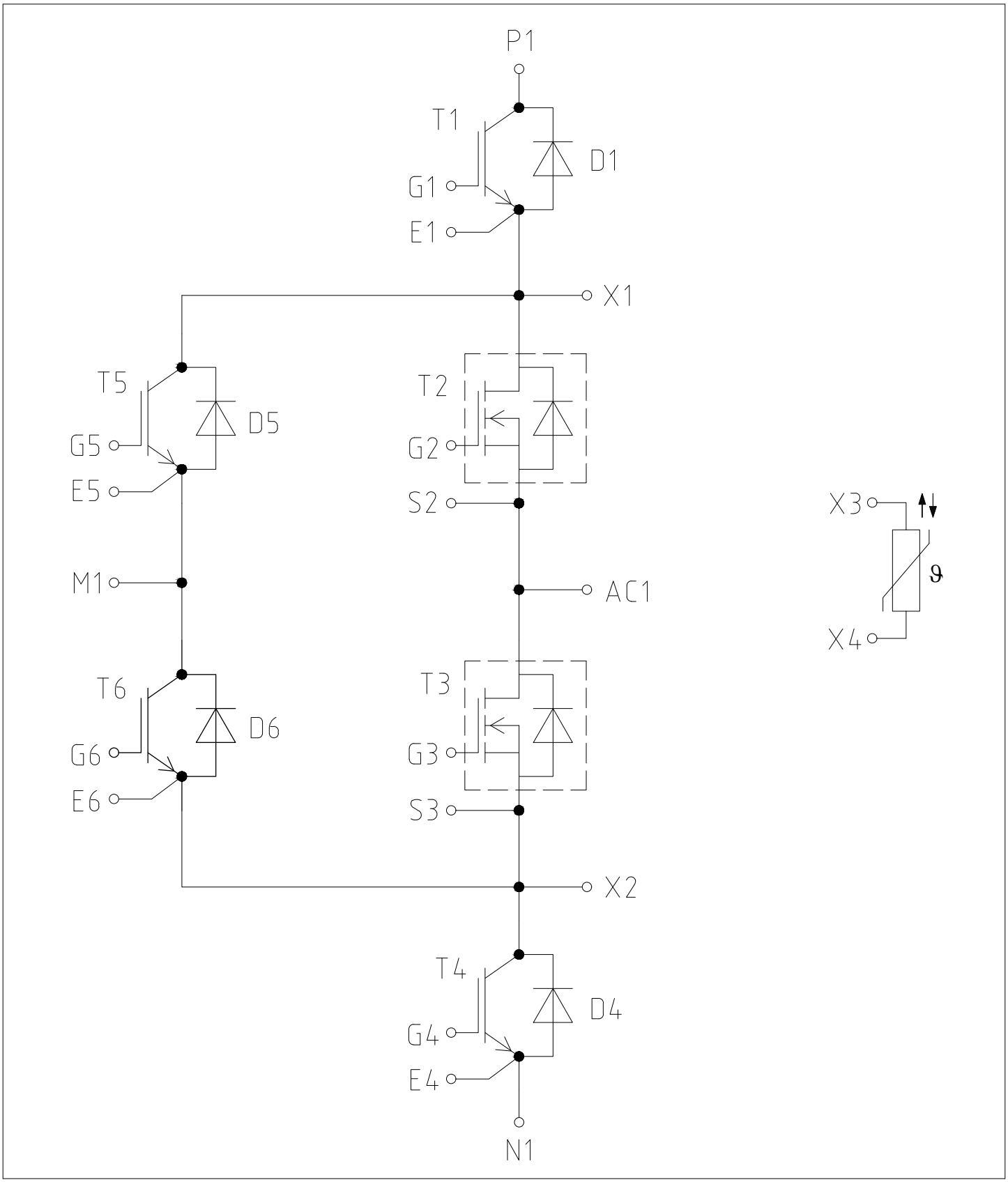
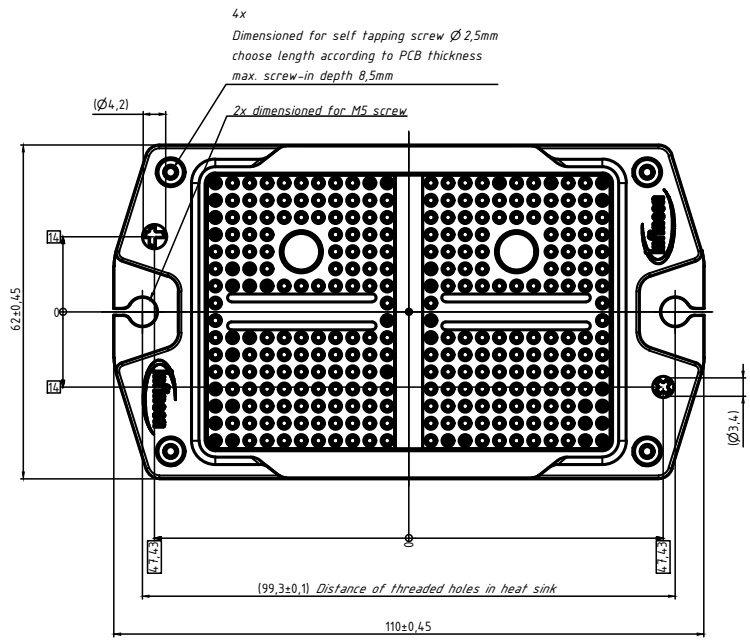
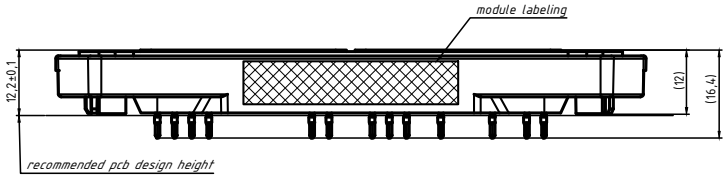


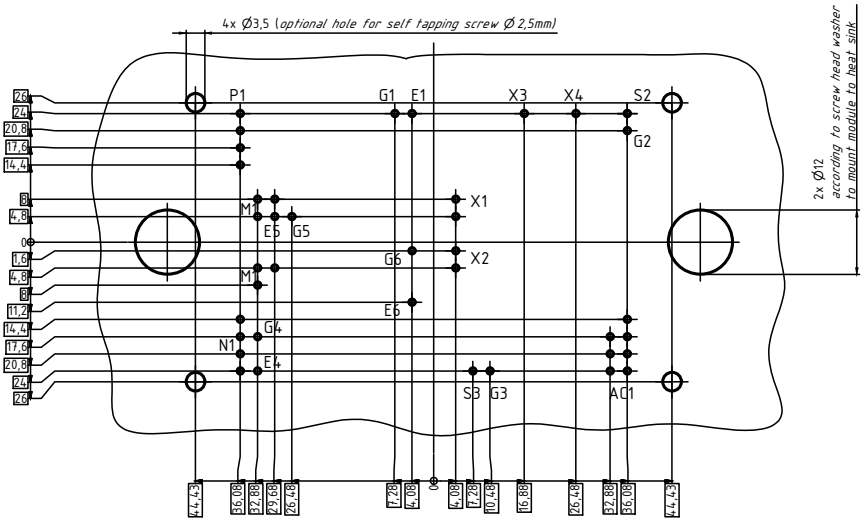
Abbildung 1

11 Gehäuseabmessungen





pcb hole pattern



- Details about hole specification for contacts refer to AN2009-01 chapter 2
- Diameters of drill Ø 1,15mm
- Copper thickness in hole 25-50um

Abbildung 2

12 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	7154914284655054991530		7154914284655054991530

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung
0.10	2023-12-20	Initial version
1.00	2024-11-12	Final datasheet
1.10	2024-11-18	Final datasheet
1.20	2025-04-01	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-04-01

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABI978-004

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.